ISSN 0389-4010 UDC 543, 442 548, 73 620, 18

航空宇宙技術研究所報告

TECHNICAL REPORT OF NATIONAL AEROSPACE LABORATORY

TR-1400

新型X線応力測定装置の高温環境下への適用

青木曲雄,大谷真一

2000年1月

航空宇宙技術研究所 NATIONAL AEROSPACE LABORATORY

目

次

第1章 緒言	1
第2章 高速X線応力測定装置の開発	2
2.1 測定法の基本	2
2.2 sin ² y 法の原理	2
2 . 3 単一入射法の原理	3
2 . 4 X 線応力測定装置の信号処理方法	4
2 .5 X 線応力測定装置の構成	6
2.6 新方式キヤリブレーションの原理	7
2 .7 新装置の測定精度の検証	7
	0
男3章 局温境項トの応刀測定システムの構築	9
3.1 加熱装直および温度計測	10
3 . 2 尚温用 4 点田げ冶具	11
第4章 CVD 製法による SiC 薄板材の X 線応力測定	12
4 .1 X 線的弾性定数の算出法	12
4 . 2 室温での X 線的弾性定数の測定	12
4 . 3 X 線的弾性定数 , X 線応力定数の測定結果	13
4 . 4 SiC 薄板材の残留応力測定	13
4 . 5 測定結果	14
4.6 高温での SiC 薄板材の X 線応力定数測定	15
4.6.1 粉末を用いた無ひずみ状態回折角の測定	15
4 . 6 . 2 高温 X 線応力定数の算出結果	15
第二帝一次却没把叶不又有这句测完	16
第5章 / / 2型迴住时の X 緑心 / 測定	10
5. 忌冷却时のA線心力測定	17
5.2 /そ却迴柱での破損許1曲	19
第6章 高温・多点応力測定の精度の検証	19
6.1 再現性の検討	20
6.2 加熱時の多点応力測定	21
6.2.1 試験方法	21
6.2.2 結果の検討	22
第7章 結論	23
謝 辞	23
参考文献	23

新型 X 線応力測定装置の高温環境下への適用

青木由雄*1,大谷真一*2

Application of Newly Developed X-Ray Stress Measurement Equipment for High Temperature Environment

Yoshio Aoki , Shin-ich Ohya

ABSTRACT

Carbon-carbon composites coated by silicon carbide have been planned for use as the material for thermal protection structures of the spaceplane. To evaluate the high temperature strength characteristics of these materials, it is necessary to measure the stress induced by repeated thermal shock at the boundary of the coating layer or by connecting these composites with primary metal structures, and the major focus was speeding up the X-ray stress measurement. The point of improvement for the speedup was to measure two positive and negative diffraction profiles of X-ray injection angle by means of two detectors using PSPC type tubes. This speedup was also achieved by integrating the heating equipments with a stress analyzer, and by developing the software to control the system accurately and collect the measurement data. This is improvement enabled stress measurement under transient phenomena during heating.

Key words: X-ray stress analysis, Thermal shock test, Single exposure technique, Actual stress, Residual stress, Carbon/Carbon Composite, FGM coating

概 要

炭化珪素をコーティングされたC/C複合材料は宇宙往還機の熱防護構造材料として有望視されている本 材料の高温強度評価の一環として,急速加熱・冷却を繰り返した環境でコーティング層,あるいは耐熱複合 材と金属主構造の結合部などの局所領域に発生する応力を解析するため、X線応力測定装置の測定の高速化 を行った.高速化に当たり改良した点は,検出器に駆動走査の不要な位置検出型比例計数管(PSPC)を採 用し、一つのX線入射角に対する回折環において角度の異なった二つの回折線を二台の検出器で測定するこ とで高速測定を可能にした.また,高速X線応力測定装置と加熱装置などの各装置を統合し,的確な制御と データ収集を行うために必要なソフトウェアを開発したことで高速化が達成された .これらによって加熱状 熊下の過渡的な応力測定が可能になった。

第1章 緒言

現在,我が国では有翼宇宙往還機の研究開発が進めら れているが、これらの計画を実現するには厳しい温度環 境の中で大幅な構造重量の低減が不可欠である.そのた め宇宙往還機の外壁材には,炭素繊維強化炭素複合材料 に炭化珪素を蒸着処理し耐酸化機能を付与することで高 比強度に加え,耐酸化性,耐熱衝撃性を向上させた材料 の適用が具体化されてきている.これら革新耐熱複合材 料の強度評価を行うには,熱負荷の繰り返しなどの実働 負荷状態下でコ - テング層と母材との界面 あるいは 繊

^{*}受付け 平成11年9月7日受付(received 7 Septembe 1999) *1 構造材料総合研究グループ(Structures and Materials Research Center) *2 武蔵工業大学(Musashi Institute of Technology)

維と母材との界面に代表される接合部,および,これら 耐熱複合材と金属主構造との結合部に生じる熱応力を的 確に解析する手法の確立が必要である.

本研究では,金属材料の残留応力解析として有効なX 線回折法に着目した.従来のX線応力測定法は,Macherauch らによって提唱されたsin²y法が多く利用され,鉄鋼材料 のみならずセラミックス系材料の測定にも十分に対応で きるものである.しかし,sin²y法は1点の応力測定に複 数の入射角の設定が必要とされる.また,汎用のX線応 力測定装置に搭載されているX線検出器であるシンチ レーションカウンターは駆動走査によって回折強度の測 定を行うため非常に時間を要し,測定精度を保ちながら 高速測定を行うことは困難である.

そこで,著者らは,熱負荷の繰り返しなど動的負荷状 態下での応力を的確に解析できる高速X線応力測定装置 の開発を行った.考案した装置¹⁾²⁾は検出器に駆動走査 の不要な位置比例計数管(Position Sensitive Proportial Counter;以下PSPC)を採用した一次元検出器により,一 つのX線入射角に対する回折環において角度の異なる二 つの回折線を二台の検出器で測定することで高速測定を 可能にしている.

また,材料加熱技術に関しては,高周波誘導加熱に着 目して,平板状のコイルを用い材料の板厚方向に磁力線 を発生させ誘起電流の損失を改良した誘導加熱装置を構 築した.

ここでは,急速加熱・冷却を繰り返した環境下で結合 部などに生じる応力を解析するためにX線応力測定装置 と加熱装置などの各装置を統合し,的確な制御とデータ 収集を行う上で必要なソフトウェアが開発され,評価シ ステム全体の機能の向上が図られた.本測定システムの 有効性を確認する目的で SiCコ - ティング付カ - ボン複 合材料を供試材として高温環境下での応力測定が行われ, 高速測定が実証された.

第2章 高速X線応力測定装置の開発

2.1 測定法の基本

本 X 線応力測定装置に採用した測定の基本は, X 線の 入射角を変えない単一入射法 <u>Single Exposure Technique</u>, 以下 SET 法)を基本とする.

単一入射法は現在標準的に行われているsin²y法による X線応力測定を発展させた方法である.

ここでは,はじめにX線応力測定法の基本概念として sin²y法について記述する.次にSET法について記述する.

2.2 sin²y法の原理

多結晶材料に波長1の特性X線を入射させると,図1 に示すようにBraggの回折条件を満たす結晶粒によって, X線は回折する.このとき,X線の波長1は結晶の(hkl) 面の格子面間隔 dと回折角 gにおいて表される.

$$l = 2d \sin q \tag{1}$$

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$
 (2)

ここで a:格子定数 h, k, l: ミラー指数 $\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$: 立法晶時の指数

材料表面の結晶が応力 s_x により無ひずみ状態の格子間 隔 d_0 から d_0 + Ddに変化した場合,それに伴うqの変化量 Dqは,式(1)を全微分し,波長1は一定であるのでD1= 0であることに留意すれば,次のように求まる.

添字0は無ひずみ状態を表す.添字 f は試料面法線と 結晶面法線のなす角.

$$Dq = q - q_0 = \tan q \ (Dd / d_0)$$
 (3)

従って,無ひずみ状態からの回折角の変化Dgを測定すれば格子面間のひずみDd/Dd₀を求めることが出来る.

つぎにこの格子面間のひずみを弾性論を用いて応力に 変換する必要がある.図2に示すように格子面の方向を



図1 X線回折現象の概要図

考慮したとき測定表面の垂線から s_x 方向に y 傾いた OP 方向の格子面間隔 d_y が X 線回折により測定できるので, その y 方向の格子ひずみ e_y は以下のように表せる.

$$e_{f} = \frac{d_{f} - d_{0}}{d_{0}} = -\frac{1}{2} \cot q_{0} (2q_{f} - 2q_{0})$$
 (4)

ここで実際の測定では2qを測定するので表現をqから 2qに代えてある.また図中の s_1 , s_2 , s_3 は点0に作用 している主応力である.($s_x + s_y = s_1 + s_2$, $s_3 = 0$)

材料は等方均質体で,材料の表面では平面応力状態で あり,X線侵入深さ方向に応力勾配を持たせないという 仮定の基では格子ひずみe_fと応力_{Sx}との関係はつぎのよ うに示すことができる.

$$e_{f} = \frac{1+\nu}{E} s_{x} \sin^{2} y - \frac{\nu}{E} (s_{x} + s_{y})$$
 (5)

ここで E はヤング率, v はポアソン比である. また,式(5)に式(4)を代入すると次式が得られる.

$$2q_{f} = \frac{2(1+v)}{E \cot q_{0}} s_{x} \sin^{2} y - \frac{2v}{E \cot q_{0}} (s_{x} + s_{y}) + 2q_{0} \quad (6)$$

そして,式(6)を $\sin^2 y$ について微分すると式(7)が 導かれる.

$$\frac{\P 2q}{\P \sin^2 v} = \frac{2(1+v)}{E \cot q_0} s_x$$
 (7)

従って,2つ以上の入射角 $_Y$ (実際は4点以上が望ましい)の位置における回折角 $2q_y$ を測定し, $\sin^2 y$ に対して2 q_y をプロットした線図($2q - \sin^2 y$ 線図)を描き,その回帰直線の傾きを求めれば応力 s_x は次式で算出できる.

$$s_x = \frac{\P 2q}{\P \sin^2 y}$$
 (8)

ここで,KはX線応力定数であり次式で定義される.な お ₂/180をかけたのはラジアン単位をディグリー単位に 変換するためである.

$$K = -\frac{E}{2(1+\nu)} \frac{p}{180} \cot q_0$$
 (9)

以上の手順によりX線応力が求められるわけであるが, sin²y法は等方均質弾性体を仮定してsin²y線図を求めて いるため,特に粗い結晶組織や強い集合組織を有する材料,あるいは研削加工面など深さ方向に急激な応力勾配 を持つ材料はsin²y線図が直線関係を保持できないので適 用が難しくなる.

従って,sin²y線図はX線応力測定の精度を検出する上 でも内部構造の影響を見いだすためにも重要な線図であ る.実際に応力測定を行う際には,被測定材料の回折面 と特性X線との組み合わせを考慮することが重要である.

2.3 単一入射法の原理

単一入射法の原理は,一つのX線入射角に対する回折 環においてy角の異なる(y1 = y0 - h y2 = y0 + h)二



図2 ひずみと応力の関係

つの回折強度曲線をそれぞれ測定し,そのピ-ク位置 2q₁,2₂を求め,次式により応力を算出する方法である.

なお,hはX線回折強度を検出するための角度パラメー タであり,被測定材料によって異なる値をとる. 図3にX線入射角と回折環の位置関係を示す.

$$\boldsymbol{s}_{x} = \mathbf{K} \quad \mathbf{M} \tag{10}$$

$$M = \frac{\P 2q}{\P \sin^2 y} = \frac{2q_2 - 2q_1}{\sin^2 y_2 - \sin^2 y_1}$$
(11)

K:X線応力定数

この式からもわかるように,sin²y線図における傾きを 2点で決定することになるからsin²y線図を作成する必要 がなくなり,X線応力定数Kを求めておけば簡単に応力 を算出できる.そして2つの回折角を測定するだけで応 力を算出できることから,測定時間の短縮が図れ,測定 速度が要求される動的に変化する応力を測定するには有 効な応力測定法である.その反面,sin²y線図からの惰報, たとえばX線侵入深さ内の表面層における深さ方向の応 力勾配の有無,集合組織や粗大結晶粒などの情報が得ら れず,応力が見かけ上算出できても測定可能な結晶状態 か否かは判断できないという欠点がある.

単一入射法は2つの回折角から応力を算出できるが, 測定誤差を小さくするにはX線入射角 $_{Y_0}$ を選択する必要 がある.いま,X線入射角における回折角における2つ の回折角 $2q_1$, $2q_2$ の測定誤差が一定と仮定したとき, \sin^2y_2 - \sin^2y_1 の値が大きくなるようなX線入射角 $_{Y_0}$ を



図3 単一入射法の測定原理図

$$f(y_0) = \sin^2 y_2 - \sin^2 y_1$$

= $\sin^2 (y_0 + h) - \sin^2 (y_0 + h)$
= $\sin 2h \sin 2y_0$ (12)

ただし式中で2h:回折角の補角h₁ = h₂ = hとしている. この式で(y₀)が最大値になるのはy₀ = 45 であり,単 一入射法で測定誤差の少ない応力測定を行うためには X 線入射角 y₀を45 に設定すれば良いことが判る.

2.4 X線応力測定装置の信号処理方法

高速化を図るために,駆動操作を必要としない位置敏 感型比例計数管(Position Senitive Proportional Counter,以 下 PSPC)を開発したので以下に構成を記述する.

本製作したPSPCはアノード抵抗線方式の電荷分割型で あり、その構造の概略図を図4に示す.コの字型のカソー ド(黄銅)の中央に、陽極として直径7 mm、長さ50 mm のカーボンファイバー(5 kW/cm)を一本張ってあり、そ の両端は信号処理装置に接続されている.またアノード の片端にはガス増幅のための高電圧(約1000 V)が印加 されている.X線検出器の窓はベリリウム(厚さ0.3 mm) を用いている.検出ガスはPRガスを用いたが、ガス流入・ 流出弁にストップバルブを用いて封入方式としている.

次に本研究に使用した電荷分割型位置検出システムを



図4 アノード抵抗型 PSPC の構造

図5に示す.電荷分割法による位置検出原理は以下の通 りである.

いま X 線照射がアノード下端から位置 X の点に入った とすると, X 線照射によりガス増幅された電荷は, それ ぞれのインピーダンスの逆比として内分され, 両端に接 続された電荷増幅器に入力される.それぞれの電荷増幅 器における出力電圧を V_A , V_B とすると V_A /(V_A + V_B) の割算を行うことにより X 線照射の位置(X/L)が求ま る.

信号処理回路を概説すると、分子信号である V_A は一端の電荷増幅器出力を波形整形することで作られ、また分母信号である $(V_A + V_B)$ は両端の増幅器の出力をアナログ加算器に入力しこの出力を波形整形することにより作られる、分母信号が波高弁別の設定範囲内であれば分子・分母信号ともにリニアーゲートを通過し、ストレッチャーで時間ピークの波高値が保持され各々AD変換される.このAD変換値に乱数発生器からの拡張ビットを加えてディジタル信号 D_A および D_{A+B} が得られ、分母のディジタル信号 D_{A+B} はROMに書き込まれているテーブルを参照し逆数 $1/D_{A+B}$ を得る.次に乗算器により

Ads = (メモリーフルスケール)×(D_A)×($1/D_{A+B}$)

の演算および有効数字の処理後,Adsの値に該当するメ モリーアドレスの内容に1が加えられる.したがって一 定時間回折X線の計数を繰り返せば回折強度曲線はメモ リーチャンネル(アドレス)に対するX線計数値のヒス トグラムとして得ることができる.

実際の検出装置は検出器(PSPC)を回折環の - h側お よび + h側の回折線測定位置に設定されている.そして, 信号処理は2個のPSPCを直列に接続し1台の割り算器を 介して,1台のメモリー部(メモリーチャンネル数 512 ch)に接続する方法が採用されている.

本装置は2個のPSPCからの回折X線の位置情報を,2 つのPSPCの合成抵抗値を有した1個のPSPCからの出力 として同時に信号処理が行われる.

ここで得られた全体の回折強度曲線において, - *h*側の PSPC の抵抗を R₁, + *h*側の PSPC の抵抗を R₂ とする と,回折強度曲線を構成するメモリー数M₁および,M₂は

 $M_1 = 512 \times R_1/(R_1 + R_2)$ ch

図5 電荷分割型位置検出システム

 $M_2 = 512 \times R_2/(R_1 + R_2)$ ch

となる.

つまり得られた回折線1~M1チャンネルまでが-*h* 側の回折線であり,M1+1~512チャンネルまでが+ *h*側の回折線である.

従って,極端に抵抗値の異なるPSPCの組み合わせでは 各々の回線を構成しているメモリー数が大きく異なり, 回折角決定の際の誤差により応力測定精度は低下する.

今回,製作した小型PSPCの抵抗値は28 kw 程度であり, ほぼ256 チャンネルを境に - h, + h側の回折強度曲線が 構成されている.

2.5 X 線応力測定装置の構成

当初,著者らがX線応力測定装置は鉄鋼材測定用とし て開発したので,それ以外の材料を測定することはでき なかった.その原因を挙げると,Fe材を測定するに際し て使用される特性X線はCr - Ka線,回折面はa - Fe(211) 面を用いるためにPSPCは2g0 = 156.4 の位置に固定され ており,測定範囲は153 ~ 156 と狭いものであった.ま た,X線回折強度曲線のピーク位置をPSPCで測定して チャンネルに保管し,メモリチャンネルアナライザを経 てコンピューターにて角度に変換される.従って,チャ ンネルと角度の関係の校正式を求める作業(キャリプ レーション)が必要である.実際に鉄鋼材を測定するに おいては,特性 X 線として Cr - Ka 線を用い,基準とし て無ひずみ状態の材料を必要とするために,Fe 粉末の回 折角156.4。並びにCr粉末の回折角153.17 を測定し,チャ ンネルと角度との校正式を求めた.しかし,この方式は 特性 X 線の種類や測定対象となる材料が変わった場合に は,検出器が固定であるために測定できない欠点を有し ていた.

以上のような問題点を解決するためにはPSPCの検出で きる回折線の範囲を広げることが最低限必要である.ま たキャリプレーションについては方式自体改善しないと 特性 X 線が変わるたびに PSPC の検出可能範囲内の2種 類の粉末を用意しなければならないので,キャリプレー ションが煩雑になる.そこでこれらの間題点を解決する ためにPSPCの設置角度を可変とする新たな装置を開発し た.図6に X 線応力測定装置の光学配置図を示す.本装 置の特徴を以下に記述する

- 1) PSPCの設置角度を可変とする目的で h, + h両側 の PSPC にゴニオメータを取り付けた.この結果 PSPCの測定できる回折範囲は146 から159 の範囲 になり従来装置に比べ + 10°拡大した.この結果検 出できる回折線の範囲を広げることができ,これに 伴って応力測定できる材料の対象も広り,本研究の セラミックス材料の測定が可能になった.
- 2) 改良した検出装置は無ひずみの粉末を2種類用いる 必要がなく,キャリブレーションは測定対象材料の



図6 X線応力測定装置の光学配置図

粉末だけで行えるようになった.

2.6 新方式キヤリブレーションの原理

新装置ではPSPCの設置角度が可変となったため次のような新たなキャリプレーション方式が可能となった.図 6に示した2機のPSPCを中立位置からa⁶傾けた位置で 測定対象材料の粉末の回折強度曲線を得て半価幅法(回 折強度プロファイルの半価幅を求め回折角を決定する方 法)にてピークチャンネルP₁を決定する.測定対象材料 の無ひずみ状態の回折角2_℃はX線応力測定に使用する 特性X線が決まれば決定されるので,各々のPSPCでそれ ぞれ

$$2q_0 + a_{(deg.)} = A P_1 + B$$
 (13)

が成り立つ.次に図6の+h側のように,PSPCを中立位 置に戻し,測定対象材料の粉末の回折強度曲線を得て半 価幅法にてピークチャンネルP2を決定する.このときも 回折角2g2とP2の間には各々のPSPCで

$$2q_{0(deg.)} = A P_2 + B$$
 (14)

がそれぞれ成立する.従って式(13),(14)より係数A, Bが決定されるのでチャンネルと角度の校正式が決定される.図7に新方式キャリブレーションの原理の模式図 を示す.

このことから新方式のキャリブレーションでは従来方 式のように PSPC の X 線検出範囲内に回折する 2 種類の 粉末を用意する必要がなく測定対象材料の粉を用いるだ けでよく,特性X線を変えた場合にも新たに PSPCのX線 検出範囲内に回折する 2 種類の粉末を探す必要がない. 従って測定準備段階での大幅な時間短縮が大いに期待で



図7 キャリブレーション方式

きる.

なお新方式キャリブレーション用の数値処理プログラ ムはキャリブレーション操作に合わせ図8に示すフロー チャートに従って開発した.

2.7 新装置の測定精度の検証

新装置での測定が従来装置と比較してどの程度の精度 で測定が行えるかを検証した.検証に使用した鉄鋼材料 のX線応力測定の条件を以下に示す.特性X線として CrKa線,回折面はaFe(211)面を使用した.なお使用X 線管球と回折面の組み合わせにおいて無ひずみ状態の回 折角2%しは日本材料学会の推奨値156.4 を用いた.

図9は二粉末方式と一粉末方式でのキャリブレーション時に得られた回折強度曲線の一例を示す.図10に両方 式よるキャリブレーションより得られた角度 - チャンネ ル線図を示す.

キャリブレーションによる応力の誤差は次のように考 えられる .2 粉末方式の場合 ,半価幅法によりピークチャ ンネルが決定されるが , ピークチャンネルが誤差を持て



図8 キャリブレーションのフローチャート





ば応力値の誤差として現れてくる.表1にキャリブレーション時の各回折角に対するピークチャンネルの偏りを示す.これらの平均値をピークチャンネル決定時に生じうる誤差とするとPSPCの角度の偏りD2gはA_{-h},A_{+h}の絶対値の平均値より

$$D2q_{2pow} = \pm (0.103 \times 0.1535)$$

= $\pm 0.0158 \circ$
$$D2q_{1pow, P} = \pm (0.110 \times 0.1328)$$

= $\pm 0.0146 \circ$

と算出できる.

なお,添字の2POWは二粉末方式,1POW.Pは一粉末方 式・パウダーであることを表す.

ゴニオメータ1°走査ことによって生じる誤差は+ h, - h双方の平均をとっておよそ± 0.08 (ch) 生じる.本 実験ではゴニオメータを2°走査してキャリプレーション を行った結果,PSPCの操作に伴って生じる角度誤差は以



図10 キャリブレーションでの角度 チャネル線図

Method	PSPC	2 。	Peak channel (average, ch)	Peak Channel (ch, 68.3% Reliability)
		153.17	103.413	0.169
2 Dowdor	-	156.4	139.353	0.121
2-Powder	+	153.17	409.544	0.153
		156.4	376.044	0.171
		158.4	158.413	0.052
1-Powder -	-	156.4	139.11	0.093
		158.4	356.463	0.2
	+	156.4	376.047	0.186

表1 キャリブレーション時のピークチャンネルの偏り



誘導加熱制御装置

図11 高温環境下の応力測定システム構成図

下の値を得た.

 $D2q_{IPOW.G} = \pm (0.08 \times 2 \times 0.110)$ = $\pm 0.0176^{\circ}$

なお,添字の1POW.Gは一粉末方式の角度であることを 表す.従って単粉末方式のキャリブレーションによる PSPCの最大誤差は,パウダーによる誤差とゴニオメータ による誤差の和として以下で得られる.

$$D2q_{lpow} = \pm (| D2q_{lpow,P} | + | D2q_{lpow,G} |)$$

= ± 0.0322 °

と算出できる.

これより本装置での鉄鋼材料の応力測定で生じうる最 大の応力測定誤差Dsは応力定数Kを - 318(MPa/deg)と すれば

 $Ds = \pm | - 318 \times 0.0322 |$

= ± 10.23 (MPa)

となる.実際に鉄鋼圧延加工材の残留応力を測定した場合,150~200 MPaの値となる.従って,実用測定においては,150~200 MPaが下限界測定値と考えられるので最 大誤差が±10.23(MPa)程度なら実用測定において問題 はないと考える

第3章 高温環境下の応力測定システムの構築

本章では高速X線応力測定装置と超高温加熱装置を統 合した図11に示すような高温環境下の応力測定システム について述べる.

従来のX線応力測定装置は,粗大結晶を有する材料に 対しては一般に同じ位置の結晶を繰り返し測定する揺動 法を用いたが,この測定法は時間がかかることが欠点と されている.高速X線応力測定装置は回折角2qを正負2 台の検出器で測定し高速化を図っているが,計測値2点 から回帰直線を求め応力を算出するので誤差を生じる可 能性があった.そこで測定精度の向上を図るために従来 は1箇所の測定のみであったが,新たに近傍の箇所を測 定し,4点の平均を用いて応力を算出する方法を考案し てソフトウェアを構築した.本システムはVisual Basicに より,図12に示すフローチャートにしたがって各装置が 制御される.

3.1 加熱装置および温度計測

加熱装置について,広範囲の加熱面を要する試験には セラミックス発熱体を用いた加熱炉を構築した.本加熱 炉の性能は,上限温度1700,常用1500,加熱領域は 200 mm × 150mm,昇温時間1000 /20 min である.

急速加熱・冷却試験には高周波誘導加熱装置を用いた. 加熱コイルには平板状コイルを試作し材料の板厚方向に 磁力線を発生させ誘起電力の損失を改良し、従来、表皮 効果の為にカーボン積層複合材料は加熱できなかった問 題を,本加熱方式を採用したことで解決させた.図13に 誘導加熱の模式図を示す.誘導加熱装置は装置の取り扱 いが容易で加熱炉の製作の必要がなく,試験片を空気中 むき出しの状態で約1000 程度まで加熱できる.また有 効加熱距離が約50mmと短く応力測定装置に熱的影響を ほとんど与えず,約30mm離れた試験片を十分加熱でき る特徴がある.実際に加熱中の応力測定装置の検出器の 温度を測定したところ50 以上には昇温しないことを確 認したことで応力測定装置に熱防護板などの取付けは行 わなかった.なお,温度測定にはデジタルマルチ温度計 を使用し,温度の検出はB型熱電対を用いた.回線は RS232Cで通信接続を行い,コンピュータからの測定信号 で一回の計測時間は約20 msec であった .図14に700 ま での加熱・冷却過程の温度線図を示す.温度の安定には 多少の時間を要したが,15分ほどで設定値に達した.ま

た,電源を切ると試験片は大気中で完全に自然冷却と なった.



図12 X線応力測定操作フローチャート







図14 加熱冷却線図



図15 誘導加熱による四点曲げ試験状況

3.2 高温用4点曲げ治具

温度変化に伴う応力の測定を行うためには温度をパラ メ-タとしたX線応力定数を測定する必要がある.この ため,新たに耐熱温度が約1300 を有する石英ガラスを 用い,高温時にも応力負荷が可能な4点曲げ試験治具を 製作した.図15に誘導加熱によるSiCコ-ティング付与 C/C複合材料の四点曲げ試験の状況を示す.曲げ試験は 試料ホルダの端部2支点間におもりを吊り下げ,中央2 支点間の試験片表面に引張応力を負荷した.構成部品す べての素材にSiO₂ガラスを使用した.SiO₂ガラスは高温 時の伸び量が極めて少ないため負荷応力の誤差はほとん どない.試験片ホルダは試験片表面に引張と圧縮の両方 を負荷できる2種類の治具を設計し,表面き裂による応 力解放が予測される場合にも試験を可能にした. 第4章 CVD 製法による SiC 薄板材の X 線応力測定

4.1 X線的弾性定数の算出法³⁾

X線応力測定はBraggの回折条件を満足する多結晶体 中の特定方向の結晶粒の特定回折面間隔の変化を測定す ることでひずみを求め、応力値を算出するものである.そ のため,このひずみが機械的に求められる巨視的なひず みとは異なることもある.それゆえ,X線応力測定には, X線的に求めた弾性定数が必要である.X線的弾性定数は 負荷応力値が既知であれば,それとX線的に測定したひ ずみを関係づけることにより求めることができる.

ここでは,単軸引張り負荷で,ヤング率 E_{X-ray} とポアソン比 v_{X-ray} をX線回折的に求める方法を述べる.試験片に既知の単軸応力 s_A を加えると,X線応力測定法の基礎式(5)から, e_y と s_A の関係は次式で表される.

$$e_f = \frac{1+\nu}{E} s_A \sin^2 y - \frac{\nu}{E} s_A \qquad (15)$$

式(15)を sin^2y について微分すると次式を得る.

$$\frac{\P e_{f}}{\P \sin^{2} y} = \frac{1+v}{E} s_{A} " M$$
 (16)

さらに s_A で微分すると,次式を得る.

$$\frac{\P M}{\P s_A} = \frac{1+\nu}{E} \, " \, \frac{1}{2} S_2 \tag{17}$$

一方,式(15)でy=0と置き,ひずみ_{ey}=0を_{SA}で 微分すると式(18)が得られる.

$$\frac{\P e_{f=0}}{\P s_{A}} = -\frac{1}{E} " S_{1}$$
 (18)

そして,(17),(18)式を連立するとEとvは

$$E = \frac{1}{(1/2S_2 + S_1)}$$
 (19)

$$v = \frac{S_1}{(\frac{1}{2}S_2 + S_1)}$$
(20)

実験では種々の既知の単軸応力 s_A における $e_y - \sin^2 y$ 線図の傾き M と y 切片 $e_y = 0 \in X$ 線的に求め,図16のような M - s_A 線図, $e_y = 0 - s_A$ 線図を描くと各々の線図の傾きが X線弾性コンプライアンス $1/2S_2$, S_1 となる.

4.2 室温でのX線的弾性定数の測定

前述した X 線弾性定数の測定原理に基づき,特性 X 線 に Fe - Ka線,回折面に(331)面を用い各応力負荷時の 2qを測定した.測定に用いた応力装置は理学電機のストレインフレックスMSF - 2M型である.sin²y線図における sin²y値の有効範囲は 0°から 0.7°であるので範囲内に均等に y 角を 7 点設定した.また結晶粒が比較的大きいことを考慮して y 方向に ± 2 の揺動を行い,照射面積を4×4(mm²)とした.その他の詳細な測定条件を表 2 に示す.

SiC薄板材の試験片形状は幅 10 mm,長さ70 mm,厚 さ0.15 mmの薄板である.試験片を図17 に示す.試験片 への負荷は4 点曲げを採用し,荷重負荷用ホルダおよび 4 点曲げ用ジグは使用したX線応力測定機にあわせて設 計製作した.なお負荷方法は荷重負荷用ホルダの端部2 支点間に錘をつり下げ,中央2支点間の試験片表面に引 張応力を負荷した.なお材料力学的に試験片の断面係数



Characteristic X-ray	FeK	Irradiated area (mm ²)	4 × 4
Diffraction	331	Scan width (deg.)	149 °~ 154 °
Diffraction Angle 2 0	151.227 °	Scan step (deg.)	
Tube voltage and current	30kV, 9mA	Peak area (150.5 °~ 152.5 °)	0.05 °
Filter	Mn	other	0.1 °
Oscillating (-direction)	±2°	Detecter	S.C.

表 2 MSF-2M 設定条件

)

と負荷モーメントから求めた応力値を負荷応力とした.



図 17 CVD 法による - SiC 薄板試験片

4.3 X線的弾性定数,X線応力定数の測定結果
図18に各応力負荷時の e_y - sin²y 線図を示す.これらの線図の傾き Mと線図のy切片 e_f = 0を各負荷応力に対してプロットしたものが図19である.ここで,式(17)の1/2S₂ は図19のs - M線図の勾配を表しておりX線弾

性コンプライアンス $1/2S_2$ である.また式 (18)の S_1 は $s_A - e_f = 0$ 線図の勾配を表しておりX線弾性コンプライ アンスS1となる.そして $1/2S_2 \ge S_1$ よりX線回折法で 求めた材料のヤング率 E_{X-ray} および v_{X-ray} を算出した.

表3にX線回折法で求めた弾性定数とX線応力定数を 示す.

4.4 SiC 薄板材の残留応力測定

単一入射法およびsin²y法による応力測定の条件を表4 に示す.通常,単一入射法において,入射角は応力測定 の感度上,つまり測定精度が最もよくなる45°が望まれ る.しかし著者らが開発した装置でFeKa線を用い(331) 回折で45°入射すると装置の幾何学的関係上回折線が試料



図 18 負荷応力における - sin² 線図



表3 X線弾性定数,X線応力定数の測定値

Characteristic X-ray	FeK	X-ray elastic constants	
Diffraction	331	E _{x-ray} (GPa)	404 ± 11
X-ray compliances (MPa ⁻¹)		X-ray	0.26 ± 0.02
1/2S ₂ × 10 ⁻⁶	3.13 ± 0.02	X-ray stress constant	
S ₁ × 10 ⁻⁶	-0.65 ± 0.02	K (MPa/deg.)	- 716 ± 8

表4 X 線応力測定条件

Method	sin²	SET
Characteristic X-ray	FeK	FeK
Diffraction Plane	331	331
Tube voltage (KV)	30	30
Tube current (mA)	9	6
K Filter	Mn	Mn
Detecter	S.C.	PSPC
Oscilation (deg.)	2	none
angle (deg.)	19, 27, 33,	20.65,
	39, 45, 51,	49.35
	57	

および試料台に干渉し得られない.本実験では入射角を 35 %に設定した.また, $\sin^2 y$ 法ではX線照射面積を $4 \times 4 (mm^2)$ としy方向に±2 %揺動を行い,単一入射法で はX線照射面積をf3(mm)とした.また試験片はCVD 法による SiC 薄板材(厚さ 150 mm)を用いた.

4.5 測定結果

図 20 に単一入射法による応力測定時の回折強度曲線 を,図 21 に sin²y 法と SET 法による 2q - sin²y 線図を示 す.図 20 を見ると - hおよび + h側の両回折強度曲線と も S/N 比が非常に良好なことが確認できる.これはX線 応力測定を行う際にピーク位置を半価幅法にて決定して



図20 残留応力測定時の回折強度曲線



図21 両測定法によるSiC² 線図の比較

いるが, S/N 比が良好だと, このピーク決定の精度が上 がり,精度のよい応力測定が可能である.従って本試験 片の応力測定も高精度で行えることが確認できる.また, 図21 に示すとおり両測定法による sin²y 線図においても 同一の値を得た.以上の結果,単一入射法を基本にした 応力測定装置はsin²y法を基本とした装置と同等の精度で かつ高速な応力測定が可能であることが確認された.

4.6 高温での SiC 薄板材の X 線応力定数測定

4.6.1 粉末を用いた無ひずみ状態回折角の測定

X線応力定数の測定には応力定数算出式に示すように 無ひずみ状態回折角 ^①値が必要である.更に今回の場合 は各温度での正確な無ひずみ状態回折角が必要とされて いる.そこで各温度での無ひずみ状態回折角の測定を 行った.

SiC粉末は誘導加熱によって電磁誘導されないため 黒 鉛基材をまず加熱し,間接的にSiC粉末を加熱した.SiC 測定には製作した単一入射法装置を用い,SiC粉末は PSPCキャリプレーション(角度 - チャンネル校正)に用 いたものを使用した.結果の一例を図22に示す.無ひず み状態回折角は単一入射法では - h,+h側で同値をとる ため - h, + h側の両方において3回行い,合計6回分の 平均を一次回帰した.X線応力定数算出では(式21)を 温度に対する無ひずみ状態回折角として使用した.

$$2q = -1.52 \cdot 10^{-3} T + 151.334 \text{ (deg)}$$
 (21)

4.6.2 高温X線応力定数⁴⁾⁵⁾の算出結果

通常のX線応力定数の算出は任意の負荷応力を試験片 に与え、そのときのひずみをX線で測定した回折角2gか ら求められる.しかし今回のような冷却中の測定の場合、 温度が一様に変化している途中で負荷応力を変更するこ とは不可能である.前項の粉末の回折角2gの変化を見る と温度変化に対して一次的に変化していることがわかる. そこで今回のX線応力定数算出は、まず各負荷応力での 冷却中のひずみ測定を行い、それぞれの線図を一次回帰 して任意の温度でのひずみから分配M を求め、M と 負荷応力から1/2S2を求めた.そして得られた各温度での 1/2S2と前項で示した無ひずみ状態回折角から応力定数を 算出した.

高温環境下のX線応力定数の算出は,負荷応力0,16, 30,44,59 MPaの5種類を試験片に4点曲げ負荷し,冷 却過程での温度と2qの関係を求めた.図23と図24に結 果の例を示す.これらの線図を一次回帰し,そして温度 と2q(ひずみ)の線図の勾配M を算出する.次にX線 応力定数の算出式(10)を用いてX線応力定数を求めた. 図25にX線応力定数Kの変化を示した.

なお,X線応力定数は得られた結果を次式の関数で表し,



図22 温度変化に伴う2 0の変化



図24 温度と回折角2 の関係(44MPa)

 $K(T) = -250 \cdot \exp(-1.19 \cdot 10^{-3}T)$ (MPa / deg) (22)

はこの値を使用した.

測定温度を代入することにより任意の温度でのX線応 力定数を算出した.以降の温度変化中のX線応力測定に 第5章 冷却過程時のX線応力測定 本章では開発したX線応力測定システムを用いて700



図25 温度とKの関係



図 26 SiC コーティング付カーボン焼結材

から室温までの自然冷却時と強制冷却時の SiC 膜に生 じる応力を測定した.次に試験片の蒸着膜のき裂発生⁶⁾ を確認するために破壊限界の応力を試験片に負荷し,き 裂発生と測定応力との関係について考察した.供試材は 黒鉛基材に SiC を CVD 蒸着⁷⁾した複合材を使用した. 図 26 に試料形状を示す.

5.1 急冷却時のX線応力測定

ここでは,高速X線応力測定装置の精度と測定速度に ついて検討するために自然冷却時と強制冷却時の蒸着膜 に発生する応力の測定を行った.

自然冷却時には試験片を約600 まで加熱後、大気中に 放置し応力測定を行った。強制冷却時には試験片を約700 まで加熱後に応力測定開始と同時に試験片を強制空冷 し測定を行った。図27に強制冷却と自然冷却時の冷却線 図を示す。その結果、50 以下になるまでの時間は自然 冷却で約25分、急冷却で約2分かかった。応力測定は強 制冷却時には4秒毎に、自然冷却時には冷却の急な部分 では4秒毎に緩やかな部分では5秒毎に応力測定を行っ た。測定条件は先に行ったX線応力定数の取得試験での





条件と同じである.図28に測定した温度に対する応力変 化の様子を示す.X線応力定数は第4章で算出した温度 との関数から求めた値を使用した.測定精度は強制冷却 時と自然冷却時ではさほど差はなく50 MPa程度の変動範 囲内で測定することができた.しかし200 以下に冷却し た時点では応力値に差を生じた.自然冷却時9)の応力は 冷却に伴い初期の SiC 膜の圧縮残留応力値に近い状態と なった.一方,強制冷却時の応力は冷却に伴って引張応

力状態に変化した.

なお,温度の上昇に伴って蒸着膜に生じる熱応力は線 膨張係数 a を用いて次式で表せる.

$$s_f = E_f \text{ Da DT}$$
 (23)

ここで *s*_f: 膜に生じる応力

$Da: a_s - a_f$	(23 -	1)
	v	

 $a_{\rm S}: 基材の線膨張係数$ $<math>a_{\rm f}: 基材の線膨張係数$ DT = $(T - T_{\rm R}) + (T_{\rm s} - T_{\rm f})$ (23 - 2)

T:測定温度,T_R:室温,

 $T_s:基材温度, T_f:膜温度$

自然冷却時には基材と蒸着膜の温度差,すなわち T_s -T_fがほぼ0となり基材と蒸着膜の線膨張係数の差による 熱応力のみが膜表面に発生したものと考えられる.

一方,強制冷却においては加熱直後は膜温度T_fと基材 温度T_sがほぼ等しいが,冷却に伴い膜温度と基材温度に 差が生じ,図28に示すように蒸着膜は温度が下がって収 縮するが基材は高温のまま膨張した状態を保ち,その結 果蒸着膜に引張応力が発生したと判断できる.つまり強 制冷却時に蒸着膜に発生する熱応力は,線膨張係数の差 による熱応力と基材と膜の温度差による熱応力の和にな ると考えられる.

ちなみに強制冷却実験後,試験片を室温に十分に放置 した後に残留応力を測定したところ,その値は初期残留 応力とほとんど差はなかった.本実験では冷却時の温度 測定は膜の温度のみを測定しており基材の温度を測定し ていないため,実際に膜と基材の温度差やそれによる熱 応力の算出値と実測値の比較を行うことができなかった. したがって今後は基材温度の測定も応力測定と同期させ て行う必要があると考えている.

これらのことから膜の損傷評価あるいは製膜条件の決 定のためには,本研究で提案したような加熱冷却中にお ける膜の応力評価が必要である.なお開発したX線応力 測定装置は2秒程度の極めて短時間で測定が可能なので 強制冷却の過程においても十分に応力を評価をできるこ とが確認できた.

5.2 冷却過程での破損評価

セラミックス材料の場合,降伏点が存在せず応力の変 動が顕著に見られないうちに突然破壊するので,き裂お よび損傷発見は非常に困難である.そこで本項では負荷 応力を試験片に与え,自然冷却時の破壊までのX線応力 測定を試みた.図29に破壊までの冷却温度線図を示す. また,図30に破壊までの応力測定結果を示す.複数の試 験片を測定した結果,60 MPaの応力が負荷されるとすべ ての試験片は約300 前後で破壊した.試験片の常温で の残留応力は約-13.2 MPaで実際に試験片に発生してい る応力は46.8 MPaであり,試験片の曲げ強度は約45 MPa を得た.常温で試験片が破壊したのではなく,冷却時に 発生した熱応力によって破壊したと考えられる.

第6章 高温・多点応力測定の精度の検証

X線応力測定システムを運用するにさいして,応力測 定装置と加熱装置など各装置を統合し,さらに的確な制 御とデ-タ収集を行うソフトウェアを構築して,コン ピュ-タによる全自動計測を可能にした.

本章では,高温応力測定システムの測定精度を検証す るために実施した.試験とその結果について述べる.



図29 破壊までの冷却線図



図 31 A1 合金有孔板試験片による再現性試験結果

6.1 再現性の検討

測定精度の検証のために,航空機用アルミニウム合金 (2024 - T4)材製の有孔板試験片を用い,弾性域内の引 張試験を行った.除荷後の試料について,複数ヶ所の残 留応力を繰り返し測定し,再現性について検討した. 図31に円孔部近傍の6ヶ所を3回繰り返し測定した結 果を示す.測定結果は円孔の中心に関して若干,左右の 対称性を欠いた測定値が得られた. この原因は,試験片を試験機に装着する際に取り付け が悪く,引張りねじり負荷が加えられた影響ではないか と考ている.測定の再現性に関しては良好な結果が得ら れた.

なお,X線応力測定装置の最適測定条件は表5に示し たとおりであるが,測定速度を重要視するか,精度を重 要視するかはX線照射時のX線管の電圧,電流によって 左右される.測定精度を重要視する場合には,本装置の 限界出力より若干弱めに電流,電圧を設定することがよ い.また,測定時間を僅かでも短縮したいときには,限 界出力値に設定する.このように適用条件によって出力

測定材料	AI合金(2024-T4)
X線光学系	平行ビーム法
測定法	単一入射法
ピークサーチ法	単価幅中点法 (Center of FWHM)
X線管球	Cr - K
K X線除去フィルタ	Mn
管電圧	10kV
感電流	6 m A
X線入射角	45°(固定)
回折角2	156.7 °
応力定数	- 94MPa/deg

表5 高速X線応力測定の測定条件

の選択を必要とする.

6.2 加熱時の多点応力測定

ここでは加熱装置,応力測定装置など各装置を統合した測定システムをコンピュ-タ制御で稼働させて,SiC コーティング付与C/C複合材料を供試材にして加熱時の 多点応力測定を行い,測定精度の検証を行った.

供試材はSiCコ - ティング付与C/C複合材料である.な お,SiCコ - ティング¹⁰⁾はCVD法によって膜厚50 mmを 被覆したものである.

C/C 複合材料は基材¹¹⁾ に PAN 系の高強度繊維,マト リックスはフェノール樹脂を使い成形加工した後,1600 の焼成温度で炭化処理した,板厚3 mmのものである.

6.2.1 試験方法

本実験では,X線応力測定装置のキャリプレーション は負荷前の試験片を用いた.高温下の試験は図32に示し た試験片に測定点を定め,3回繰り返し測定した.デー タは室温,300,500,600 について取得した.試験 温度は昇温時間15分,保時間4分とした.

X線応力測定の条件を表6に,試験状況を図33に示した.また,室温から600 の各温度で加熱時の応力を測定した結果を図34に示す.図35には600 一定の温度で再現性を重点に測定した結果を示した.





図 32 SiC コーティング付カーボン 複合材料試験片

表6 高速X線応力測定の測定条件

測定材料	- SiC
X線光学系	平行ビーム法
測定法	単一入射法
ピークサーチ法	単価幅中点法 (Center of FWHM)
X線管球	Fe - K
K X線除去フィルタ	V
管電圧	10kV
感電流	6 m A
X線入射角	45°(固定)
回折角2	151.3 °
応力定数	- 317MPa/deg

6.2.2 結果の検討

加熱負荷時の応力の測定には応力測定装置をはじめ各 装置をコンピユ - 夕制御し,全自動計測で行った.試験 の結果を検討してみると,コ - ティング層の応力値は高 温になるに伴って圧縮応力が増加することが確認された. なお測定値の再現性については良い結果が得られたが, 測定箇所によっては若干のバラツキを示した.この原因 は供試材が繊維強化型の複合材料であるために材料の不 均質性に起因したものと考える.

本試験において,これまで不可能とされた,熱負荷時 における任意点の応力値が高い精度で測定できたので, 今後は温度を考慮した応力定数を使用して実用測定を行



図 33 加熱環境下の応力測定状況



図34 各温度下の応力測定結果(SiCコーティング付与C/C複合材料)



図 35 600 温度下の応力測定結果(SiC コーティング付与 C/C 複合材料)

う所存である.

第7章 結論

本研究では,宇宙往還機の熱防護構造材料の強度評価 を行うために,X線応力測定装置の高速化に着目し単一 入射法を基本とした高速X線応力測定装置を開発した. 同時に応力測定装置と加熱装置等を統合した高温応力測 定システムを構築した.本システムを用いて,自然冷却 時と強制冷却時の実時間応力測定,あるいは加熱時の多 点測定による再現性の検討が行われ,評価システムの有 効性が実証された.

以下に装置の開発事項,測定により得られた結果を記述する.

- 1)単一入射法を基本とするX線応力測定装置の検出 器に小型のゴニオメータを取り付け測定角度範囲を 広げることで,これまで測定が困難であったセラ ミックス材料等に対しても測定が可能になった.ま た,PSPCは直接角度を検出することができないた め,これまでは回折角が既知な2つの粉末材料を用 いて角度とチャンネルの校正を行ったが,ゴニオ メータの使用によって,基準となる無ひずみの粉末 は一種類で良く校正の煩雑が解消された.
- 2)構築したX線応力測定装置は一つのX線入射角に 対する回析環において角度の異なる二つの回折線を 二台の検出器で測定し高速化を図っているが計測値 2点から回帰直線を求めているので誤差を生じる可 能性があった.測定精度の向上を図るために検出器 に駆動ステ - ジを採用し,1箇所測定を2箇所測定に し計4点にて回帰直線を求めることで,結晶状態の 悪い試料においても再現性のある測定を可能にした.

3)加熱,冷却時の過渡的な応力変動の測定例として, SiC 蒸着膜の自然冷却時と強制冷却時の応力測定を 行い基材と膜の線膨張係数の差異によって生じる熱 応力を解析した.なお,強制冷却においては膜と基 材との間に温度差が生じ引張の応力値が得られた. 本研究で取得された応力測定評価技術は蒸着膜の熱 負荷時の性能評価や製膜条件の決定に貴重な指針を 与えるものと期待される.

謝 辞

本研究を行うにあたり,法政大学工学部長谷川賢一教 授には信号処理装置を構築するうえで貴重な助言と教示 を賜りました.また,実験の遂行にあたっては,武蔵工 業大学大学院生の永田好伸氏にはご助力を頂いた.ここ に厚く感謝の意を表します.

参考文献

- 1) 大谷真一他三名, 材料 Vol.40, No 454, pp. 825-831 (1991)
- 2)大谷真一他二名,第28回X線材料強度に関するシン ポジウム講演論文集,pp.5-10(1992)
- 3)日本材料学会編・改著X線応力測定法, pp.129-136 (1990) 養賢堂
- 4)A.M. Huntz and F. Sibieude; An Advanced Technique for High Temperature X-Ray Elastic Constant Mesurement and Stress Determination, Zeitschrift fur Metallkunde, Vol.84, No.2, pp.140-146 (1993)
- 5) O. N. Grigor'ev and G. S. Krivoshei; Determination of Thermal Stresses in Multi-phase Ceramic Materials, Ind.Lab.,Vol.58, No. 10, (1993), pp936-939

- 6)斉藤正弘,他二名,高温X線装置による遮熱コーティング部材の損傷評価,第33回X線材料強度に関する討論会講演論文集(1996)pp61-66,日本材料学会.
- 7)関川貴洋,他三名,C/C複合材料への高温耐酸化コー ティング,第8回超耐環境性先進材料シンポジウム, pp307 - 316,(1997)
- 8)山田常雄,他二名,傾斜組成制御したSiC/(C/C)積 層体における残留熱応力の有限要素解析,材料 Vol 40, pp63 - 68,(1991),日本材料学会
- 9)日下一也,他三名,AI薄膜の残留応力及びその場熱 応力測定,第33回X線材料強度に関する討論会講演 論文集,(1997)日本材料学会
- 10)山内宏,他二名,高性能 C/C 複合材料への耐酸化 コーティング技術の開発,第8回超耐環 境性先進 材料シンポジウム講演集,pp283 - 296,(1997)
- 11) Yu. I. Dimitrienko; Thermomechanics of Composites under High Temperatures, (1999), Kluwer Academic publishers

航空宇宙技術研究所報告 1400号

平成 12 年 1 月 発 行

 発行所科学技術庁航空宇宙技術研究所 東京都調布市深大寺東町7丁目44番地1
電話(0422)40-3075 〒182-8522
印刷所株式会社東京プレス 東京都板橋区桜川2-27-12

禁無断複写転載

本書(誌)からの複写,転載を希望される場合は,研究支援課資 料係にご連絡ください。

Printed in Japan